



SMP B-COMPONENT PLUS

POLÍMERO MODIFICADO CON SILILO

BENEFICIOS

- Proceso de curado controlado
- Unión más rápida
- Posibilidad de diseños con mayor solape

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bostik B-Component Plus es un compuesto de consistencia pastosa que se utiliza como acelerador en el proceso de curado de los adhesivos de base SMP de Bostik. (B-Component Plus forma parte del sistema Dual SMP de Bostik).

APLICACIONES

Bostik B-Component Plus (1 parte de componente B por 33 partes de adhesivo componente A SMP) acelera significativamente el proceso de curado del adhesivo y el desarrollo de la resistencia.

Bostik B-Component Plus permite solapes de unión grandes, que no curarían completamente con un producto monocomponente debido a que la humedad no puede difundirse lo suficientemente profundo en la junta de solape.

Los componentes A y B se mezclan mediante un mezclador estático. La información sobre el sistema Dual SMP de Bostik, sus componentes, consumibles y uso se encuentra en una sección dedicada de nuestro sitio web.

CARACTERÍSTICAS

- Proporción de mezcla óptima: 1:33; Una parte del componente B Plus por 33 partes del adhesivo de base SMP componente A
- Proporción de mezcla óptima para pistola aplicadora Dual SMP: 1:40. La aplicadora utiliza el componente B en cartucho de 12,5 ml
- Valor de pH aprox. 9

MÉTODO DE USO

Cuando se utiliza junto con Bostik ISR 70-05 AP, ISR 70-08 AP y MSR FT, estos componentes A deben calentarse entre 40°C y 60°C para lograr una tasa de flujo de adhesivo aceptable y una mejor mezcla durante la aplicación. El tiempo abierto del producto mezclado puede reducirse ligeramente debido al calentamiento. Se recomienda encarecidamente probar el tiempo abierto práctico antes de utilizar el sistema.

DATOS TÉCNICOS

Material base		Silyl Modified Polymer (SMP)
Densidad específica	[g/ml]	ca. 1.4
Colores		Blanco, Negro
Forma física		Pasta tixotrópica
Contenido en sólidos	[h]	ca. 74

DESCRIPCIÓN DEL EMBALAJE

Blanco: cartucho de 12,5 ml
Negro: salchicha de 600 ml y cubo de 20 l

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

Bostik B-Component Plus puede almacenarse durante 12 meses en su envase original sin abrir, en un lugar seco y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La siguiente publicación está disponible bajo solicitud:
- Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS).

Condiciones de curado de las probetas: 23°C/50%HR. La resistencia al corte se determina utilizando probetas de corte a solape simple, solape de 25x25 mm, espesor de línea de unión de 2 mm, velocidad de ensayo de 50 mm/min. El desarrollo de la resistencia se representa como un porcentaje de la resistencia final al corte para el componente A individual. Consulte la hoja de datos técnicos del componente A para obtener información adicional.

AVISO LEGAL

Bostik ofrece esta Hoja de Datos Técnicos ("TDS") únicamente con fines descriptivos e informativos. No constituye una garantía, un contrato ni un sustituto del asesoramiento experto o profesional. Consulte también la Hoja de Datos de Seguridad del producto local para consideraciones de salud y seguridad. Las declaraciones, información técnica, datos y recomendaciones contenidas en esta TDS se proporcionan "TAL CUAL" y no están garantizadas ni avaladas de ninguna manera. Representan resultados típicos para los productos y se basan únicamente en la investigación de Bostik. Dado que las condiciones y métodos de uso de los productos

están fuera de nuestro control, Bostik rechaza expresamente cualquier responsabilidad y daños de cualquier tipo o naturaleza que puedan derivarse de cualquier uso de los productos, de los resultados obtenidos o de la confianza depositada en la información aquí contenida.